This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 01311533 A

(43) Date of publication of application: 15.12.89

(51) Int. CI

H01J 1/30

(21) Application number: 63141565

(22) Date of filing: 10.06.88

(71) Applicant:

CANON INC

(72) Inventor:

SAKANO YOSHIKAZU ONO HARUTO **NOMURA ICHIRO** TAKEDA TOSHIHIKO KANEKO TETSUYA YOSHIOKA SEISHIRO SUZUKI HIDETOSHI

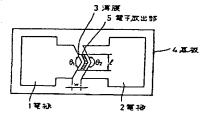
(54) SURFACE CONDUCTIVE EMITTING ELEMENT AND ELECTRON EMITTER USING SAME

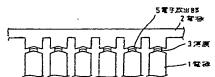
(57) Abstract:

PURPOSE: To enable the shape of an electron beam to be easily controlled so as to obtain electron emission aligned in preferable order by linearly arranging elements formed with a projecting positive electrode and a recessed negative electrode opposed to each other.

CONSTITUTION: Electrodes 1 and 2 made of conductive material are formed on an insulative substrate 4. The electrodes 1 and 2 are formed with deposition films made of metal such as Ni, Al, Cu, Au, Pt and Ag or metallic oxide such as SnO₃ and ITO. The tip of the electrode 1 is formed into a projecting shape of an angle θ (120°) while that of the electrode 2 is into a recessed shape angle θ (240°). The electrode 1 should preferably be positive while the electrode 2 should be negative. An electron emitting portion 5 is formed between the electrodes 1 and 2. The plural electrodes 1 and 2 are arranged so as to obtain a linear emitting portion 5 for performing a foaming process by each element.

COPYRIGHT: (C)1989,JPO&Japio





◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-311533

⑤Int. Cl. 4

識別記号

斤内整理番号

码公開 平成1年(1989)12月15日

H 01 J 1/30

A -6722-5C

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全8頁)

図発明の名称 表面伝導形放出素子及びそれを用いた電子放出装置

> ②特 題 昭63-141565

②出 願 昭63(1988)6月10日

⑫発	明	者	坂 野	嘉 和	東京都大田区下丸子3丁目30番2号	キヤノン株式会社内
@発	明	者	小 野	治 人	東京都大田区下丸子3丁目30番2号	キャノン株式会社内
⑫発	明	者	野 村	— 郎	東京都大田区下丸子3丁目30番2号	キャノン株式会社内
個発	明	者	武田	俊彦	東京都大田区下丸子3丁目30番2号	キヤノン株式会社内
@発	明	者	金子	哲 也	東京都大田区下丸子3丁目30番2号	キヤノン株式会社内
⑫発	明	者	吉岡	征四郎	東京都大田区下丸子3丁目30番2号	
個発	明	者	壁	英 俊	東京都大田区下丸子3丁目30番2号	キヤノン株式会社内
创出	顖	人	キヤノ	ン株式会社	東京都大田区下丸子3丁目30番2号	
砂代	理	人	弁理士	豊田 善雄	,	

1. 発明の名称

表面伝導形放出素子及びそれを用いた 武子放出装置

2.特許請求の範囲

- (1) 一対の電極を有する表面伝導形放出素子にお いて、一方の電極の形状が凸形でかつ、相対する 他方の電極の形状が凹形であることを特徴とする 表面伝導形放出案子。
- (2) 凸形の電框が正板、凹形の電框が負板である ことを特徴とする請求項第1項の表面伝導形放出
- (3) 請求項第2項に記載の表面伝導形放出案子 が、少なくとも一列、直線的に配列されているこ とを特徴とする電子放出姿置。

3 . 発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

本苑明は、裏面伝導形放出案子及びそれを用い た電子放出装置に関するもので、特に表面伝導形 放出案子から放出される電子ピームの形状制御並 びに一次元(線)又は二次元(面)状の電子放出 を行う電子放出装置に関する。

[従来の技術]

従来、簡単な構造で電子の放出が得られる素子 として、例えば、エム・アイ・エリンソン(N. 1. Elinson)等によって発表された冷陰極柔子が知ら れている。[ラジオ・エンジニアリング・エレク トロン・フィジィックス(Radio Eng. Elactron. Phys.)第10卷 , 1230~1286頁 , 1985年]

これは、基板上に形成された小面積の薄膜に、 膜面に平行に電流を流すことにより、電子放出が 生ずる現象を利用するもので、一般には要面伝導 形放出案子と呼ばれている。

この表面伝導形放出素子としては、前記エリン ソン等により開発されたSaOz(Sb)薄膜を用いたも のの他、Au薄膜によるもの【ジー・ディットマー "スイン ソリッド フィルムス"(G. Dittmer: "Thin Solid Films") . 9 卷 , 317 頁 . (1872 年)]、170 彦殿によるもの【エム・ハートウェ

ル・アンド・シー・ジー・フォンスタッド "アイ・イー・イー・イー・トランス・イー・ディー・コンフ" (S. Sartwell and C. G. Fonstad: "[EEE frans. ED Canf.") 519 頁 , (1975年)]、カーボン薄膜によるもの[荒木久他: "真空" . 第26巻,第1号,22頁。(1983年)] などが報告されている。

これらの表面伝導形放出来子の典型的な案子構成を第11図に示す。 同第11図において、 1 および 2 は電気的接続を得る為の電極、 3 は電子放出材料で形成される薄膜、 4 は基板、 5 は電子放出部を示す。

 機能を得ている。

第11図において 6 は、上記表面伝導形放出来子から放出される電子ビームの広がる面積を目視で 測定できるように、透明基板の電子ビームの照射 面に蛍光体を塗布した蛍光体基板、7 は放出され た電子ビームにより発光した発光部である。

従来の表面伝導形放出案子の放射特性は、変面伝導形放出案子から数●■程度離れた空間上に近光体基板 6 を配置して数百 V から数千 V の電圧を印加し、前記 種 1 と電極 2 の間に駆動電圧を印した場合、 量光体基板 6 上に発光する発光部 7 が第11回のごとく、 三ヶ月形をなすものとなっている。この放射特性は、 従来の表面伝導形電子放出案子の固有の特性である。

さらに、表面伝導形電子放出素子をライン状に マルチに配置した場合、第12図のごとく、三ヶ月 形の発光部7がライン状にならんだ、非常に変形 されたライン電子製を構成することになる。

[発明が解決しようとする課題]

上述のように、従来の表面伝導形放出案子は、

放出された電子ピームが三ヶ月状に広がりながら 飛翔するため、次のような欠点がある。

- (1) 表面伝導形放出案子から放出された電子ビームを任意の形状に絞るには、非常に複雑な電子 光学系を必要とする。
- (2) 安面伝導形放出案子を複数個、ライン状に規 即正しくマルチに配置した場合、ライン状に 均一な電子放出を得られない。

以上のような問題点があるため、従来の表面伝導形放出業子は、案子構造が簡単でかつ、2つ以上の複数の素子をライン状に配置することが容易であるにもかかわらず、産業上積極的に応用されるには至っていないのが現状である。

本発明は、上記のような従来の欠点を除去するためになされたもので、簡単に電子ビームの形状を制御できるようにすると共に、きれいに描ったライン状の電子放出が得られるようにすることを目的とする。

[課題を解決するための手段]

上記目的を達成するために本発明で講じられた

手段を、本発明の一実施例に対応する第1 図及び 第3 図で設明すると、本発明は、一対の電板1。 2 を有する表面伝導形放出案子において、一方の 電板1 の形状を凸形としかつ、相対する他方の電 板2 の形状を凹形にするという手段を講じている ものである。

本発明において、一対の電極1、2は、希望する電子ビームの形状に合わせて、いずれを正極としてもよいが、整った電子ビームの形状を得る上では、凸形の電極1を正極とし、凹形の電極2を負極とすることが好ましい。ここで、正極とは、正の電位が印加される電極をいっ。

特に、凸形の電極」を正極とし、凹形の電極2 を負極とした本表面伝導形放出素子は、整った形状の電子ピームが得やすいことから、当該素子を直線的に一列に並べて、一次元状の電子放出をなす電子放出装置を構成するのに適している。また、当該素子を複数列並べることにより、対象領 域全体に均一な電子ビームの照射が可能な、二次 元状の電子放出を行う電子放出装置を得ることが できる。

更に本発明について説明すると、本発明の表面 伝導形放出素子は、従来と同様に拡板 4 上に形成 されるもので、この基板 4 としては、例えばガラ ス、石英等の絶縁材料が用いられる。

電極1,2は、例えば真空蒸着プロセスとフォトリソプロセス等の通常よく用いられる方法で形成することができる。この電極1,2の材料は、一般的な導電材料で、例えばNi、Alo Cu、Au、Pt、As等の金属や、SnO:、ITO 等の金属酸化物等を用いることができる。

電極1、2間における電子放出部5の形成は、 従来と同様に、例えば1m20g、Su0g、Pb0等の金属 酸化物、Ag、Pt、Ag、Cu、Au等の金属、カーボン、その他各種半導体等の電子放出材料を用い た真空蒸着等によって薄膜3を成膜し、これに フォーミング処理を施すことで行うことができる (第1 図参照)。

出来子を直線的に一列に並べたときに、均一に 速なった電子放出状態が得やすくなるものであ る。

[実施例]

実施例 1

第1図は、本実施例に係る妻面伝導形電子放出 素子の平面図、第2図はその電子ビームの放射特性を示す説明図である。第1図に於いて、4は絶縁性を有する基板、3は電子放出材料で形成された薄膜、1及び2は電気的接続を得るための電板、5は電子放出部で、第2図において6は電子ビームの放射特性を調定するための蛍光体基板、7は最光部である。

本実施例の表面伝導形放出案子を次のようにして作製した。

絶縁性の基板4に石英基板を用い、洗浄された基板4上に、電子放出材料に Auを用いて膜厚1000 A の薄膜3 を成膜し、次いでフォトリングラフィー技術により、電子放出部5 が形成される幅 2 = 0.1mm のネック部を有する電子放出材料の稼

また、電子放出部5の他の形成方法としては、 上記電子放出材料の微粒子8を分散媒に分散に大分散液を、例えばデッピングやスピンコート等で基板4に強布した後焼成することによって行う分散としては、微粒子8を変質させることながすりない。メチルエチルケトン、シクル、アルコール類、メチルエチルケトン、シクロ、オサン及びこれらの混合物等が用いられる。また数粒子8は、数十A~数μmの粒径のものが好ましい。

[作用]

電板 1 , 2 を凸形と凹形にすることによって、 電界状態に変化をもたらすことができ、これに応 じて電子ビームの形状を変化させることができ ス

特に凸形の電板1を正板とし、凹形の電極2を 負極とすると、三ヶ月形の放射特性が、電極1, 2の形状変化に伴なう電界状態の変化によって是 正され、整った形状となり、当該表面伝導形放

膜るとした。

次いで、前記薄膜 3 に形成される電子放出部5と電気的接続を得る電極 1 、2 を、Niを用いたマスク蒸着により、1500 A の膜厚で形成した。電極 1 を先端の角度 θ ; が 120 の凸形とし、電極 2 を 先端の角度 θ ; が 240 の凹形として、電極間隔 w=0.05mmになるよう形成した。

前記電極1に正の電圧、電極2に負の電圧が加わるように、電極1と電極2の間に20Vの電圧を印加することにより、薄膜3に通電し、これにより発生するジュール熱で薄膜3を局所的に破壊、変形もしくは変質せしめ、電気的に高抵抗な状態にした電子放出部5を形成した。上記のごとく形成された電子放出部5は、電極1,2の形状に沿った形に形成された。

次に、透明基板に、青板ガラスを用い、これを洗浄した後、透明電極 170 (IngOn: SnOg = 95: 5) を蒸着により1000人の呼さで形成し、更に電子により発光する蛍光体を塗布して蛍光体基板 6 を形成した。

上記のごとく形成された表面伝導形放出来子と 世光体基板 8 を用い、当該案子に駆動電圧14 V を 印加し、蛍光体基板 6 を上記案子から約 5 mmの空間上に配置して、放出された電子ビームの放射領域、即ち発光銀アを測定したところ、第 2 図目に示すように、従来の表面伝導形放出案子では得ることの出来ない。

第3 図は、上記表面伝導形放出素子を用い、ライン状に規則正しくマルチに配置した電子放出装置の部分平面図、第4 図は、この電子放出装置による電子ビーム放出で蛍光体基板 6 上にマルチに発光した発光部7を示した説明図である。

第3図に示す電子放出装置に於いて、電極1は 凸形で、正の電圧を印加する個別電極とし、電極 2は凹形で、負の電圧を印加する共通電極とし た。上記1素子による発光部7のLが約1mmであ るため、各素子関隔を0.8mm とし、電子ビームが 低なり合うように、6素子を、電子放出部・5 が直 線的になるよう配置し、各案子ごとにフェーミン

1 , 2 の間へ、電子放出材料となる数粒子 8 として 1 次粒径 80~200 Aの SnOz を用いた分散核(SnOz: 1 g、溶剤: NEK/シクロヘキサンニ 3/1 のもの1000ccとブチラール= 1 g) をスピンコート法により塗布し、250 でで加熱処理し、電子放出部 5 を形成した。

上記のごとく形成された表面伝導形故出案子の 電振1、2の間に、電振1が正電圧、電極2が負 電圧となるよう、駆動電圧13Vを印加し、実施例 1で用いたのと同様の最光体基板6を上記案子か ら約3mmの空間上に配置して、放出された電子 ビームの放射個域、即ち発光部7を制定したところ、第5図に示すように、観留二約0.5mm、長さ L=約0.8mm の長円形の発光部7を得ることができた。

上記1素子の発光部7のLが約2mmであるため、素子関係を1.8mm として電子ビームが重なり合うようにし、凸形の電板1を個別電極とし、凹形の電板2を共通電板として、8案子を、電子放出部5が直線的になるよう配置した(第8

グを行った。

上記のごとく配置、形成した6素子を、各々前述した1素子の駆動と同じ駆動条件で駆動して電子放出させ、蛍光体基板5を発光させたところ、第4図のごとく、発光部7は、目視では各案子の発光領域の識別が不可能な、Wが約0.5mm でよが約5.0mm のライン状の発光を得ることができた。

さらに、上記電子放出装置による電子放出安定性は、1素子で±18%のゆらぎがあるのに対して、6案子のライン状電子源となることにより±12%と電子放出のゆらぎが改善された。

実施例 2

第5図は、本実施例に係る表面伝導形放出案子と世光体基板 6 の斜視図で、本実施例では、絶縁性の基板 4 に石英板を用い、電極 1 、2 を、膜厚1000 A の Niを E B 蒸着により成膜することで形成した。電極 1 を免燥の R が 9・3 mm の 凸形に、電極 2 を電極 1 との間隔 2 μmの凹形に、各々フォトリソグラフィー技術により形成した。次いで、電極

図)。

上記のごとく配置、形成した6案子を、1案子と同じ駆動条件で電子放出させ、蛍光体基板6を発光させたところ、第7図のごとく、発光部7は、目視では各案子の発光領域の識別が不可能な、甲が約18mmのライン状となった。

実施例3

第8図は、本実施例に係る表面伝導形放出案子の平面図、第9図はその電子ピームの放射特性を示す説明図である。

本実施例に係る表面伝導形放出素子は、電極 1 を先端が φ 0.3mm の凸形に、電極 2 を電極 1 との 眼隔 2 mmの凹形に形成し、電子放出部 5 を円状部 分のみとした点以外は実施例 2 と間様とした。

上記のごとく形成された、表面伝導形電子放出 素子の電極1、2の間に、電板1が正電圧、電板 2が負電圧となるように駆動電圧14Vを印加し、 実施例1と阿様の量光体基板6を上記案子から約 3mmの空間上に配置して、放出された電子ピーム の放射領域、即ち発光部7を測定したところ、 第9回に示すように、長径φ=約8.3mm の円形の 発光部7を得ることができ、電子ビームを収束す る効果が得られた。

上記案子も、実施例1,2と同様に、ライン状の電子額を構成することができ、ライン状に均一なマルチの電子放出を得ることができる。 実施例4

第10図は、本実施例に係る表面伝導形放出案子と世光体基板5の斜視図で、同図に於いて、4は 絶縁性を有する基板、9は段益形成層、5は電子 放出部、1 および2 は電気的接続を得るための電 様、8 は電子放出材料となる数粒子である。

本実施例に係る電子放出素子は絶縁性の基板 4 として石英板を用い、洗浄された基板 4 上に、段 差形成層 9 として、SiO2の液体コーティング材 (東京応化工業社製OCD)を用いて膜厚 3000 Aの SiO2層を塗布、乾燥プロセスにより形成し(他の 段差形成層として、KgO, TiO2, Ta2O5, A&2O3 等 の絶縁材料の後層物もしくはこれらの混合物があ る。)、次いで、フォトリングラフィー技術により、電子放出部 5 の段益部の先端のRが G.3mm の凹形になるよう形成した。

次いで、前記電子放出部 5 と電気的接続を得る電板1,2として、Niを用いて、マスク蒸煮により酸厚 500 Aで幅 w が 0.3 mm に なるよう形成した。この時、電子放出部 5 には、成膜時のステップカバーレージを忍くすることにより、Niが堆積しないようにした。電極1,2の間の電子放出部5となる段差部側端面に、前述の実施例 2 と同様にして、電子放出材料となる微粒子 8 を形成した。

上記のごとく形成された、表面伝導形電子放出 案子の電極1,2の間に、電極2が負電圧、電極 1が正電圧となるように駆動電圧15Vを印加し、 実施例1と同様の蛍光体基板6を上記案子から約 3 mmの空間上に配置して、放出された電子ビーム の放射領域、即ち発光部7を測定したところ、 第10図に示すように、幅平=約1.1mm 、 長さしゃ 約1.8mm の長円形の発光部7を得ることができ

t.

上記妻子も、前述の実施例と同様に、ライン状の電子概を構成することができ、ライン状に均一なマルチの電子放出を得ることができる。

また、電子放出部5の形状に関しても、前述の実施例が基板1上の電極間隔内であったものが、本実施例では、段差部上下端の電極間隔内に変っただけであり、本実施例でも穏々の電極1.2の形状を回様に得ることができる。従って、本実施例においても、前述実施例と同様に、電子ピームの形状を任意の形に制御することができる。

本発明によれば、表面伝導形放出業子の一対の電極の形状を、一方の電極を凸形、かつ、相対する他方の電極を凹形の形状に設けることにより、次の効果が得られる。

- (1) 複雑な電子光学系を用いることなく電極形状により、電子ビームを任意の形に朗仰することができる。
- (2) 上記案子の電子放出部を直線的に配置するこ

とにより、ライン状に均一な電子放出を得ることができるマルチ電子放出装置を得ることができる。

4、図面の簡単な説明

第1 図は実施例1 に係るまが放出案子の平面図、第2 図はその電子ビームの放射特性を示す設明図、第3 図は第1 図のよ子を用いたで子放出数での部分平面図の部分を開いたで、第4 図はまるのはは、第5 図はは、第5 図はは、第5 図はは、第5 図はは、第5 図はは、第5 図はは、第5 図はは、第6 図のでは、第9 図はは、第9 図はは、第9 図はは、第9 図はは、第10 図はは、第10 図はは、第10 図は、第10 図は、第10 図は、第11 図は、11 図は、11

1,2…電框 3…

4 … 基板 5 … 電子放出部

特開平1-311533(6)

8 … 数粒子

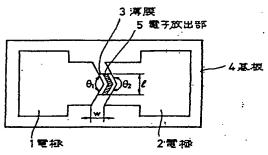
9 … 段 差 形 成 層

出顧人

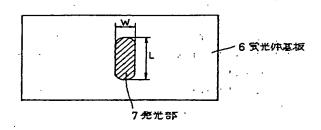
代理人



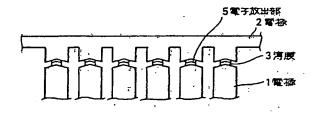
第 1 図



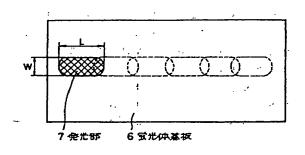
第2図

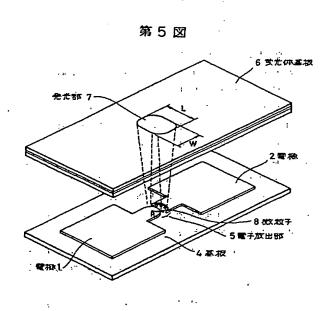


第3図



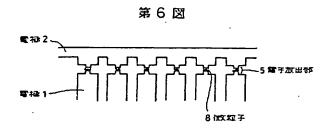
第4図





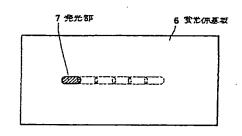
特開平1-311533(7)

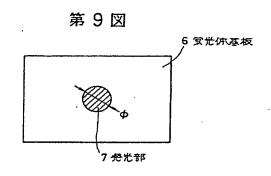
第8図



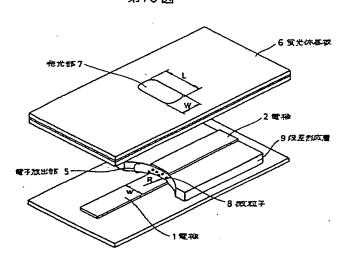
1電松 4 基板

第7図

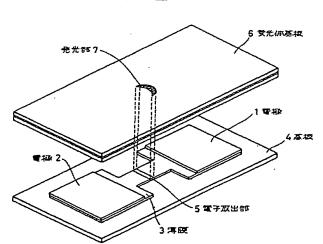








第11図



第12図

